



ЭЛЕКТРОН-МАШ

**Каталог металлокерамических корпусов
для изделий СВЧ и силовой электроники**

Москва

2026



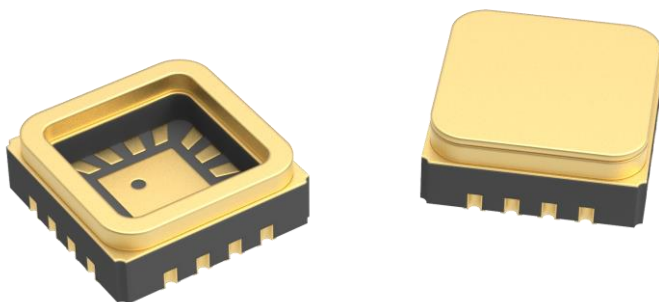
Корпуса для СВЧ МИС и ГИС	4
Корпус МК16-3030-01 (ТЛВШ.301176.022) с диапазоном частот до 25 ГГц	4
Корпус МК24-4040-01 (ТЛВШ.301176.023) с диапазоном частот до 25 ГГц	5
Корпус МК24-4040-02 (ТЛВШ.301176.023-01) с диапазоном частот до 40 ГГц	6
Корпус МК32-5050-01 (ТЛВШ.301176.024) с диапазоном частот до 25 ГГц	7
Корпус МК32-5050-02 (ТЛВШ.301176.024-01) с диапазоном частот до 40 ГГц	8
Корпус КП32-5050-03 (ТЛВШ.301176.025) с диапазоном частот до 25 ГГц	9
Корпус МК44-6060-01 (ТЛВШ.301176.026) с диапазоном частот до 40 ГГц	10
Корпус МК48-7070-01 (ТЛВШ.301176.027) с диапазоном частот до 25 ГГц	11
Корпус 5140.8-2 К (ТЛВШ.301176.006) с диапазоном частот до 6 ГГц	12
Корпус 5140.8-3 К (ТЛВШ.301176.019) с диапазоном частот до 4 ГГц	13
Корпус 5169.32-4 К (ТЛВШ.301176.020) с диапазоном частот до 20 ГГц	14
Корпуса для мощных СВЧ транзисторов.....	15
Корпус МК2-254-01 (ТЛВШ.432269.001) с диапазоном частот до 4 ГГц	15
Корпус МК2-264-01 (ТЛВШ.432269.003) с диапазоном частот до 12 ГГц	16
Корпус МК2-240-01 (ТЛВШ.432269.007) с диапазоном частот до 18 ГГц	17
Корпус МК2-340-01 (ТЛВШ.432269.008) с диапазоном частот до 4 ГГц	18
Корпус МК4-411-01 (ТЛВШ.432269.009) с диапазоном частот до 4 ГГц	19
Корпус МК2-203-01 (ТЛВШ.432269.010) с диапазоном частот до 4 ГГц	20
Корпус МК2-140-01 (ТЛВШ.432269.012) с диапазоном частот до 6 ГГц	21
Корпус МК2-203-02 (ТЛВШ.432269.013) с диапазоном частот до 6 ГГц	22
Корпус МК2-203-03 (ТЛВШ.432269.014) с диапазоном частот до 4 ГГц	23
Корпус МК4-206-01 (ТЛВШ.432269.015) с диапазоном частот до 4 ГГц	24
Корпус МК4-206-02 (ТЛВШ.432269.016) с диапазоном частот до 4 ГГц	25
Корпус МК2-5896-01 (ТЛВШ.432269.017) с диапазоном частот до 4 ГГц	26
Корпус МК2-4353-01 (ТЛВШ.432269.018) с диапазоном частот до 4 ГГц	27
Корпус МК6-245-01 (ТЛВШ.432269.019) с диапазоном частот до 18 ГГц	28
Корпус МК6-180-01 (ТЛВШ.432269.020) с диапазоном частот до 18 ГГц	29
Корпус МК2-203-04 (ТЛВШ.432269.021) с диапазоном частот до 4 ГГц	30
Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС.....	31
Корпус МК8-4050-01 (ТЛВШ.301175.004) с диапазоном частот до 7 ГГц	31
Корпус МК10-7171-01 (ТЛВШ.301175.005) с диапазоном частот до 17 ГГц	32
Корпус МК10-175-01 (ТЛВШ.301175.006) с диапазоном частот до 18 ГГц	33
Корпус МК14-175-01 (ТЛВШ.301175.007) с диапазоном частот до 18 ГГц	34



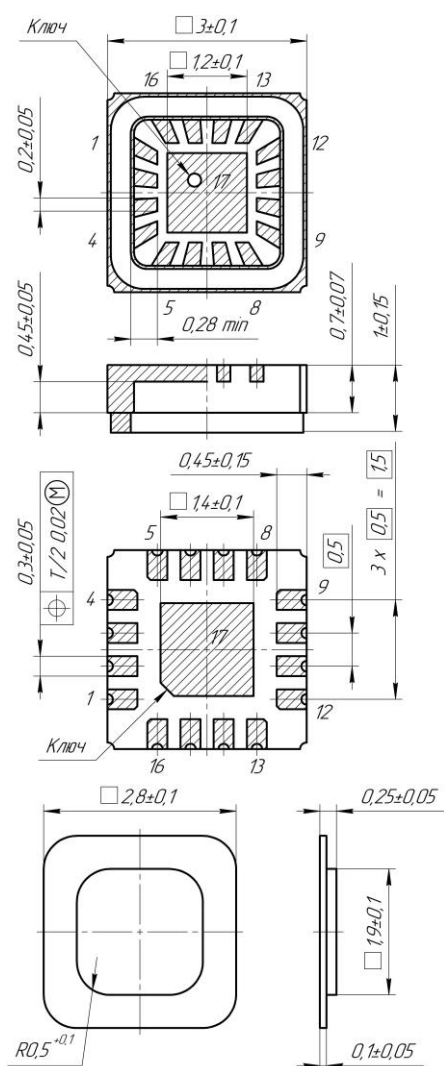
Корпус МК8-133-01 (ТЛВШ.301175.009) с диапазоном частот до 22 ГГц	35
Корпус КП8-5060-01 (ТЛВШ.301175.010) с диапазоном частот до 20 ГГц	36
Разработка и изготовление корпусов под требования Заказчика	37
Металлокерамические корпуса для изделий СВЧ-электроники.....	37
Разработка и изготовление корпусов под требования Заказчика	38
Металлокерамические корпуса для изделий силовой электроники	38

Корпуса для СВЧ МИС и ГИС

Корпус МК16-3030-01 (ТЛВШ.301176.022) с диапазоном частот до 25 ГГц



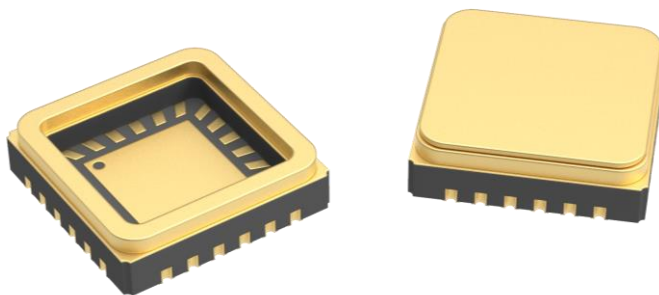
Габаритный чертеж



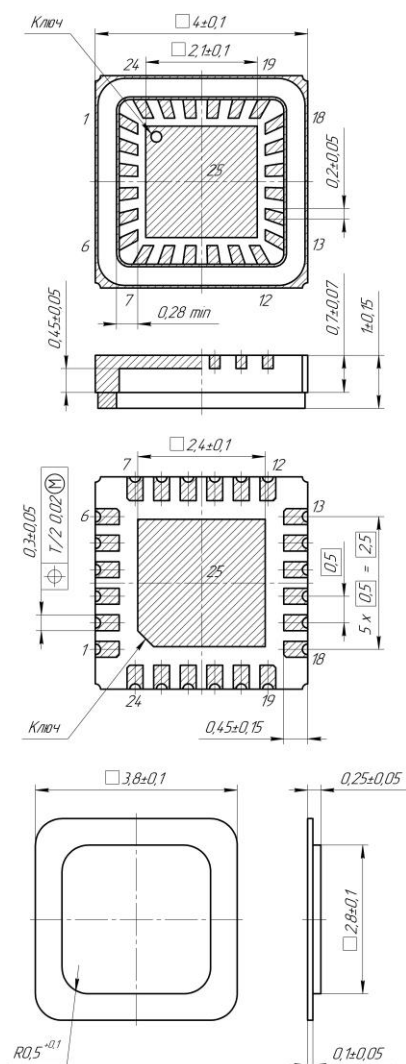
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	16
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	3,0×3,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	1,2×1,2
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..25,0

Корпус МК24-4040-01 (ТЛВШ.301176.023) с діапазоном частот до 25 ГГц



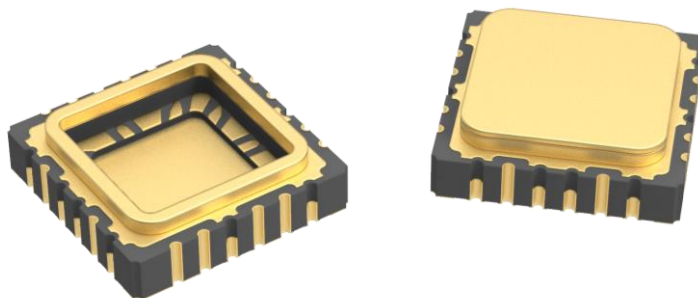
Габаритный чертеж



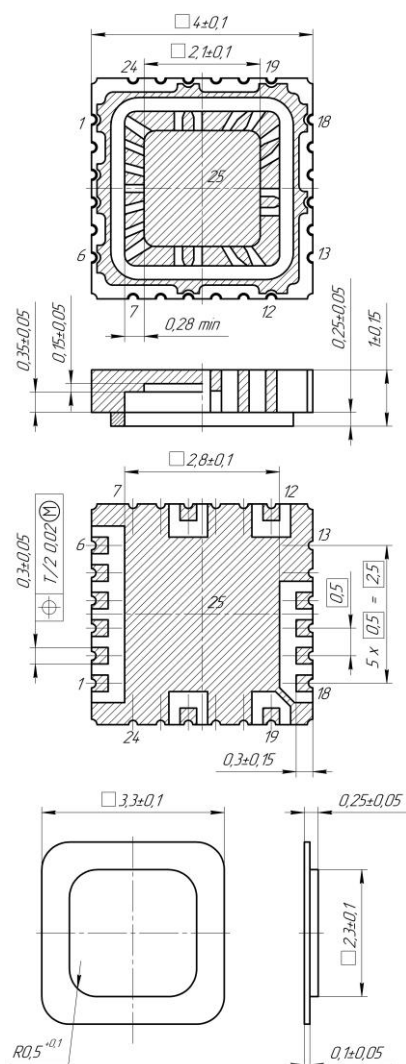
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	24
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	4,0×4,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	2,1×2,1
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 < -10 дБ	0,01..25,0

Корпус МК24-4040-02 (ТЛВШ.301176.023-01) с диапазоном частот до 40 ГГц



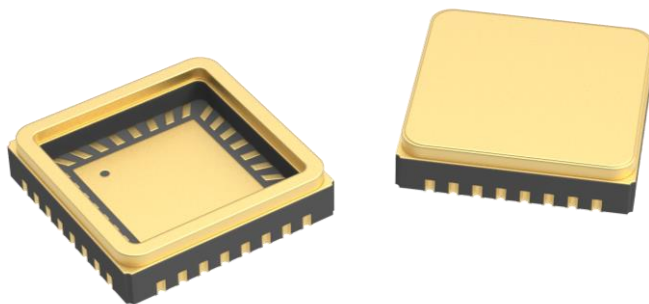
Габаритный чертеж



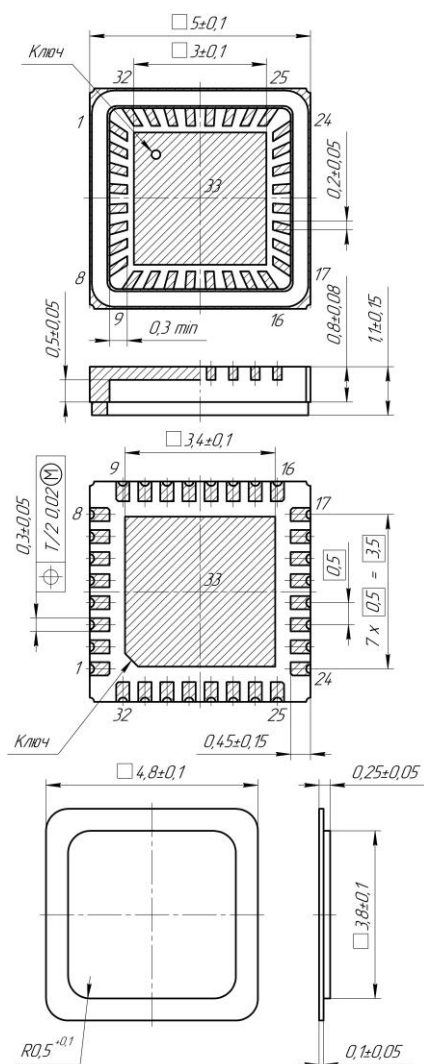
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	24
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	4,0×4,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	2,1×2,1
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, $S_{11} \leq -10$ дБ	0,01..40,0

Корпус МК32-5050-01 (ТЛВШ.301176.024) с диапазоном частот до 25 ГГц



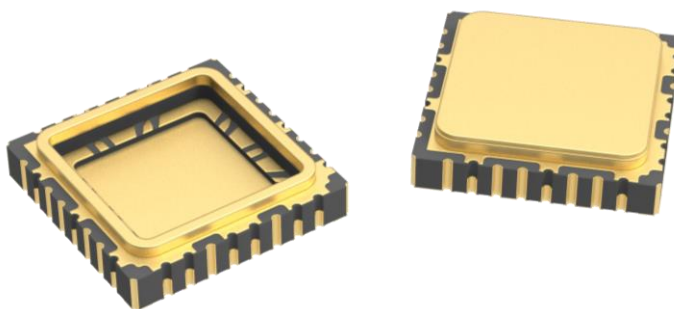
Габаритный чертеж



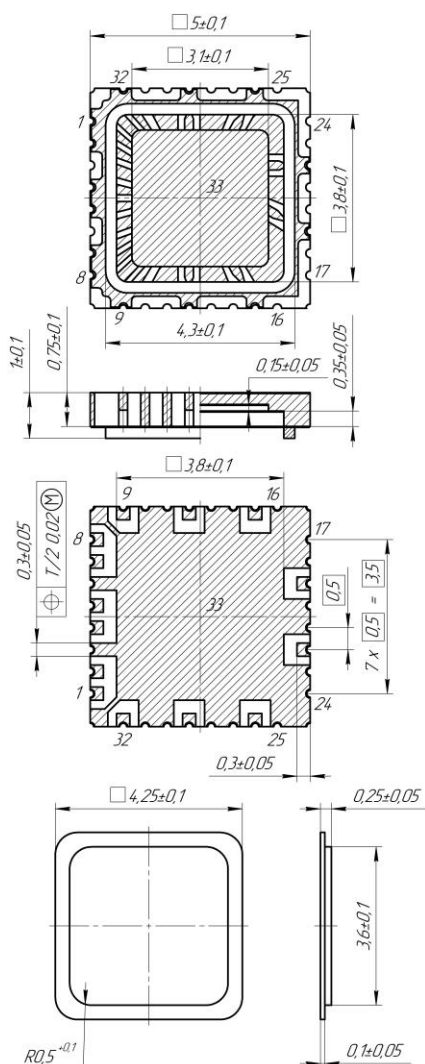
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	32
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,4
Размер монтажной площадки, мм	3,0×3,0
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..25,0

Корпус МК32-5050-02 (ТЛВШ.301176.024-01) с діапазоном частот до 40 ГГц



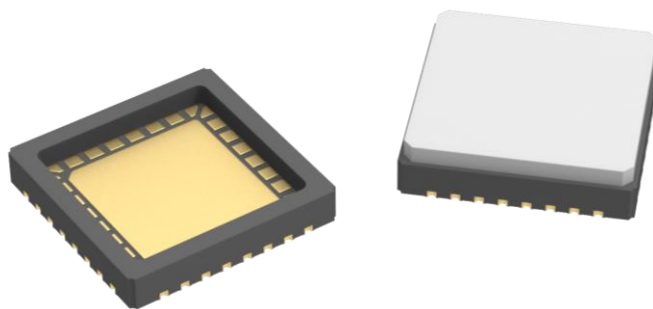
Габаритный чертеж



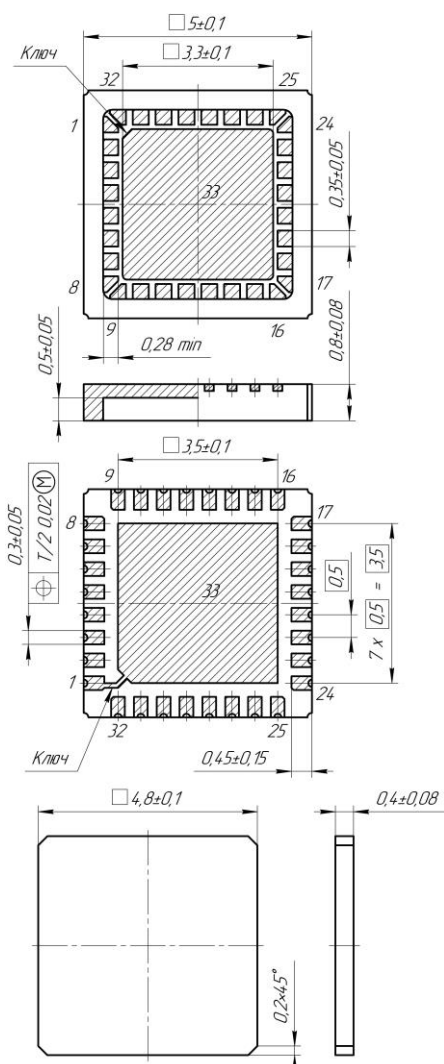
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	32
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	3,1×3,1
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 < -10 дБ	0,01..40,0

Корпус КП32-5050-03 (ТЛВШ.301176.025) с диапазоном частот до 25 ГГц



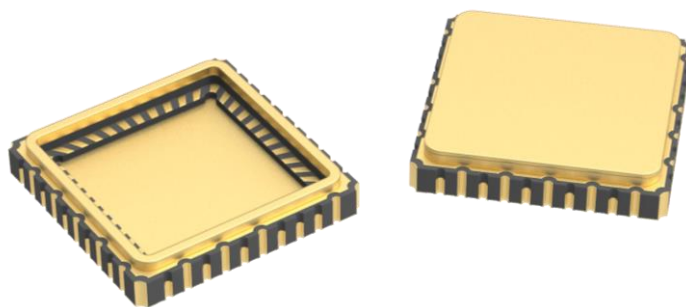
Габаритный чертеж



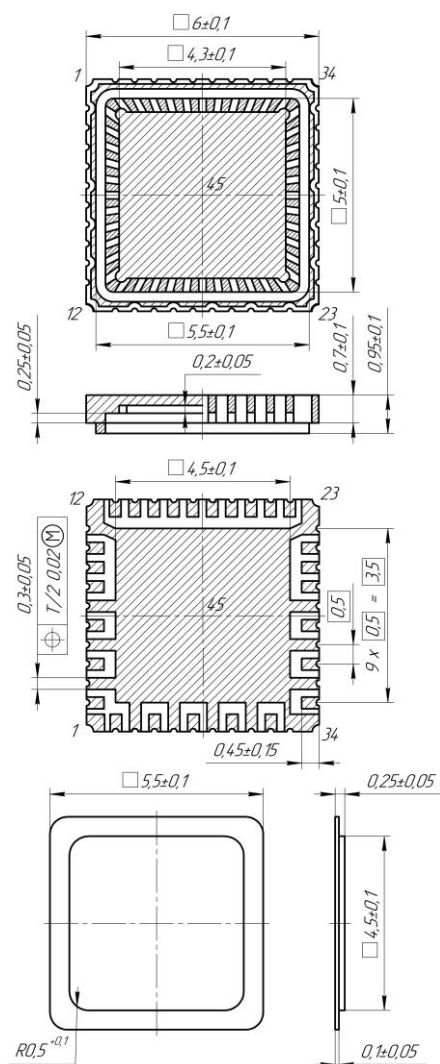
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	32
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,6
Размер монтажной площадки, мм	3,3×3,3
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	клей
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..25,0

Корпус МК44-6060-01 (ТЛВШ.301176.026) с диапазоном частот до 40 ГГц



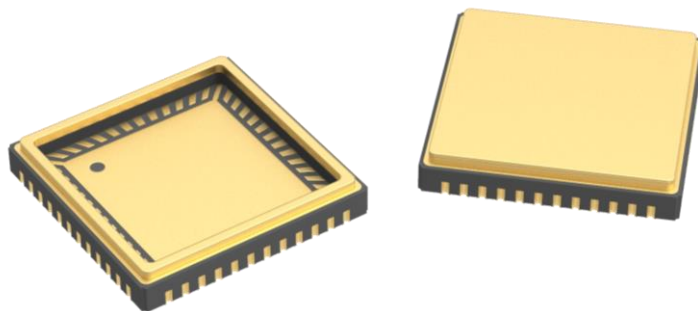
Габаритный чертеж



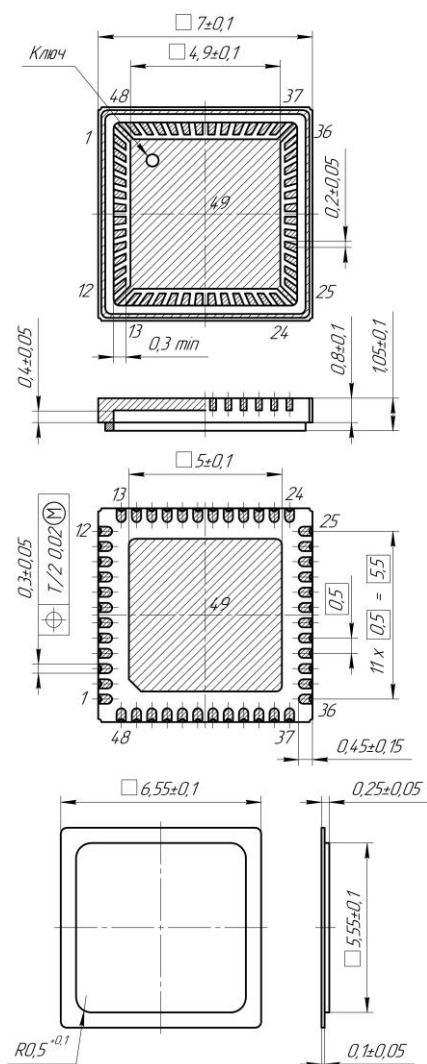
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	44
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	6,0×6,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	4,3×4,3
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, $S_{11} \leq -10$ дБ	0,01..40,0

Корпус МК48-7070-01 (ТЛВШ.301176.027) с діапазоном частот до 25 ГГц



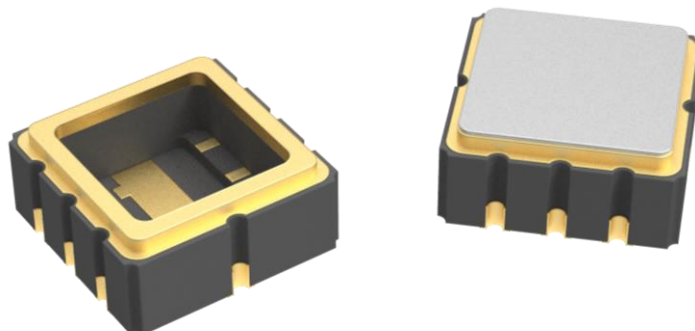
Габаритный чертеж



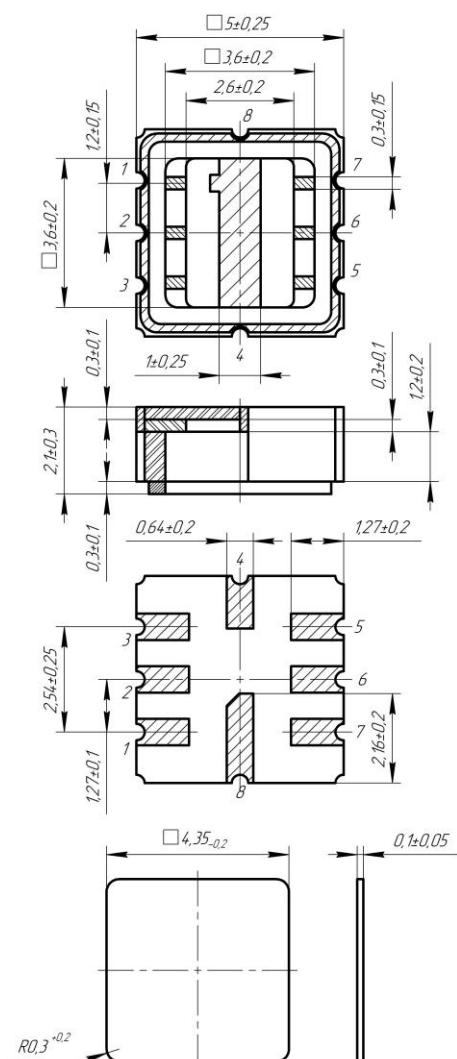
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	48
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	7,0×7,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	1,3
Размер монтажной площадки, мм	4,9×4,9
Покрытие	H2.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..25,0

Корпус 5140.8-2 К (ТЛВШ.301176.006) с диапазоном частот до 6 ГГц



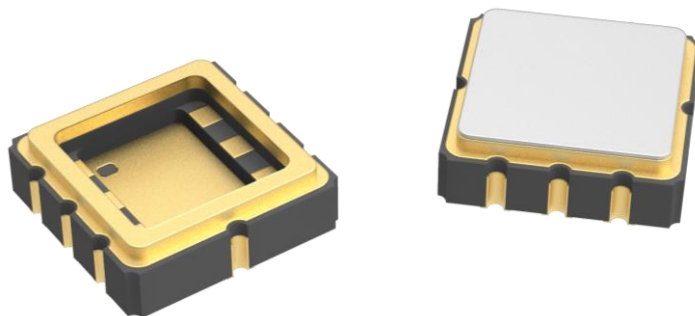
Габаритный чертеж



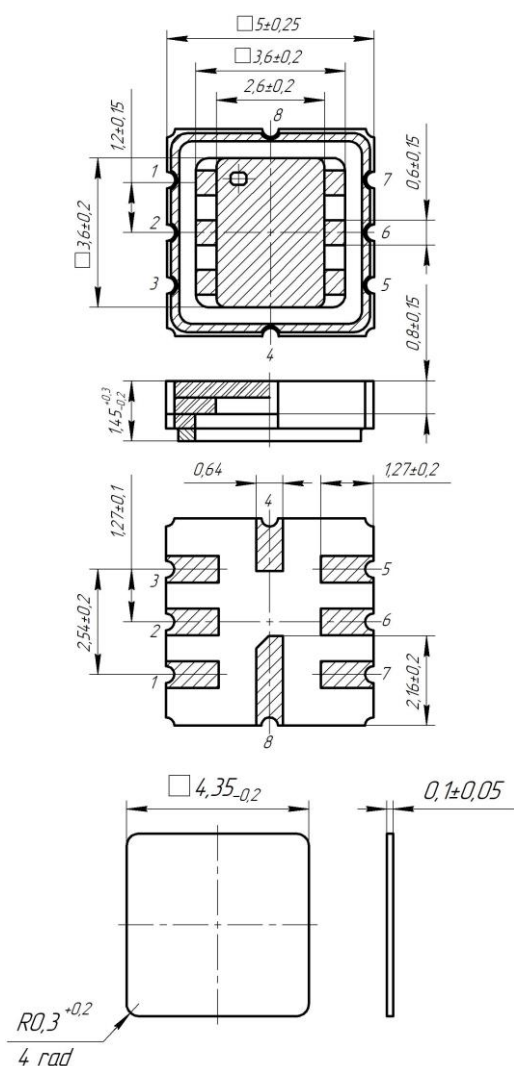
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	1,0×3,6
Покрытие	H2.3л1
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 < -10 дБ	0,01..6,0

Корпус 5140.8-3 К (ТЛВШ.301176.019) с диапазоном частот до 4 ГГц



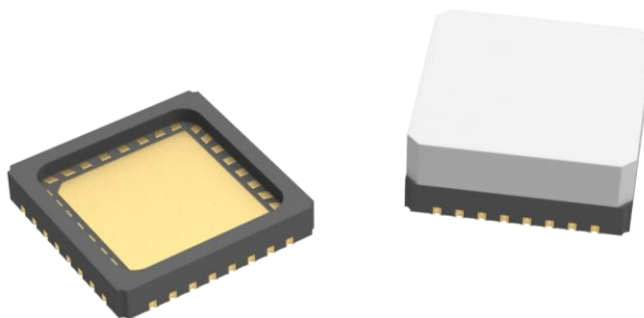
Габаритный чертеж



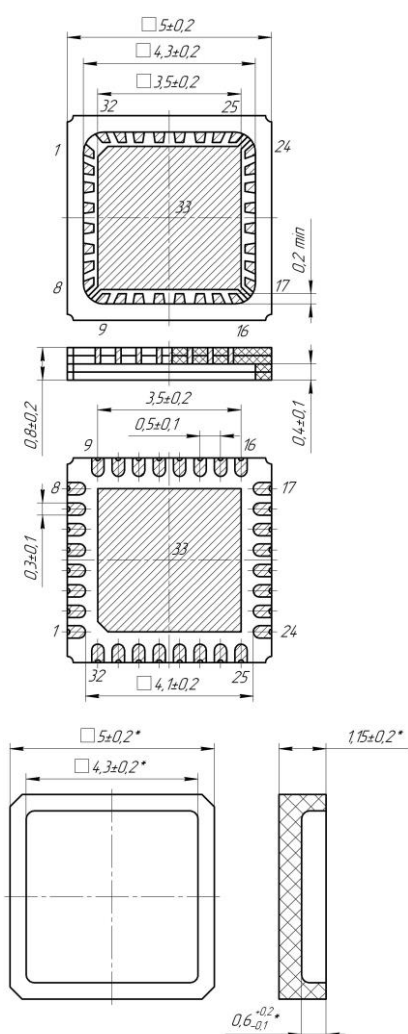
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	2,6×3,6
Покрытие	H2.3л1
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..4,0

Корпус 5169.32-4 К (ТЛВШ.301176.020) с диапазоном частот до 20 ГГц



Габаритный чертеж



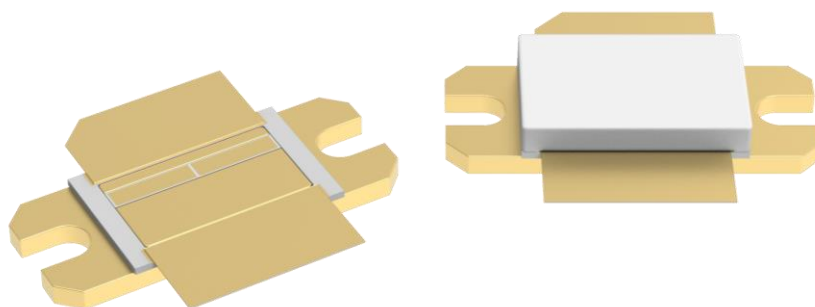
*Размеры до нанесения клея.

Технические характеристики

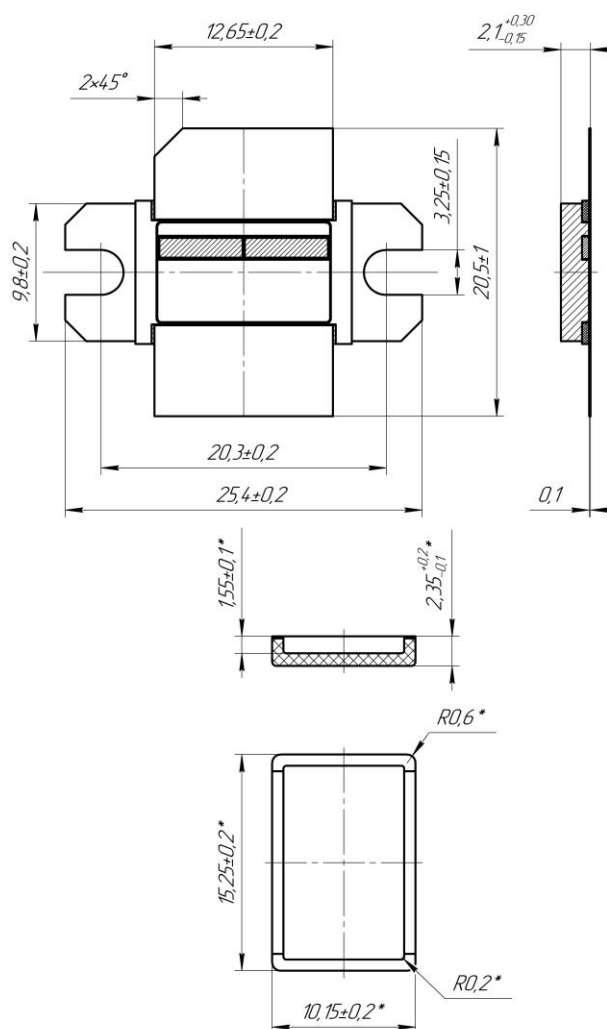
Количество выводов, шт.	32
Шаг выводов, мм	0,5
Размеры основания, мм	5,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,35
Размер монтажной площадки, мм	3,5×3,5
Покрытие	H2.3л1
Метод крепления кристалла в корпусе	клей
Метод герметизации	клей
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..20,0

Корпуса для мощных СВЧ транзисторов

Корпус МК2-254-01 (ТЛВШ.432269.001) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

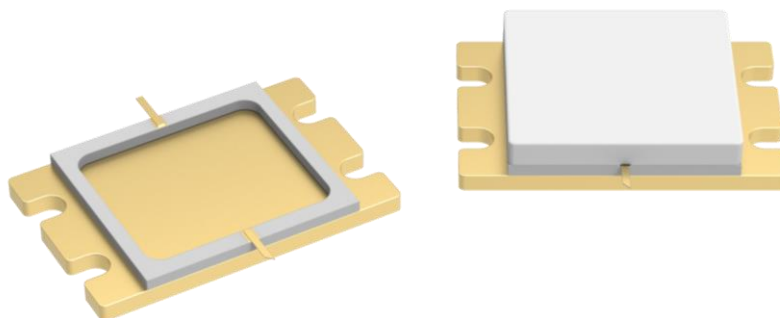


*Размеры до нанесения клея.

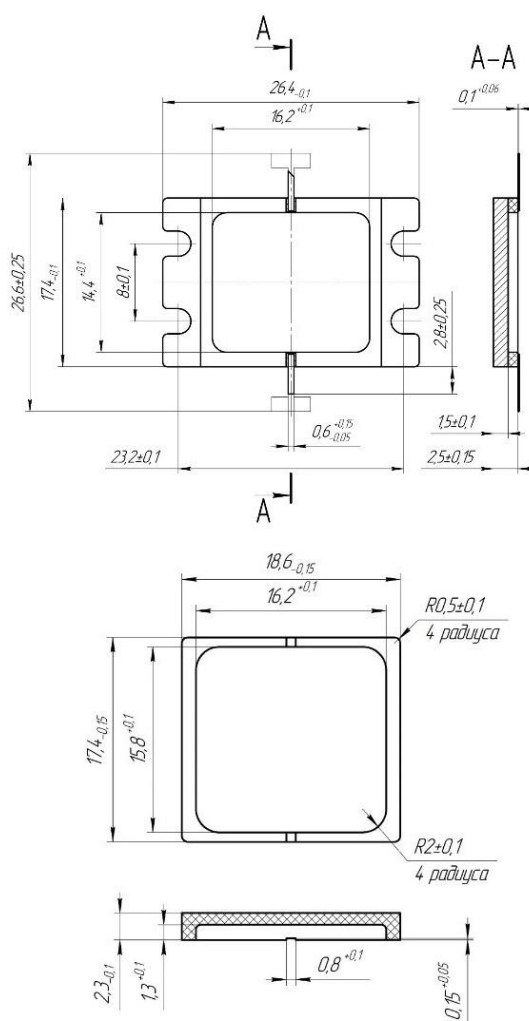
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	25,4×10,2
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	12,0×1,4
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК2-264-01 (ТЛВШ.432269.003) с діапазоном частот до 12 ГГц



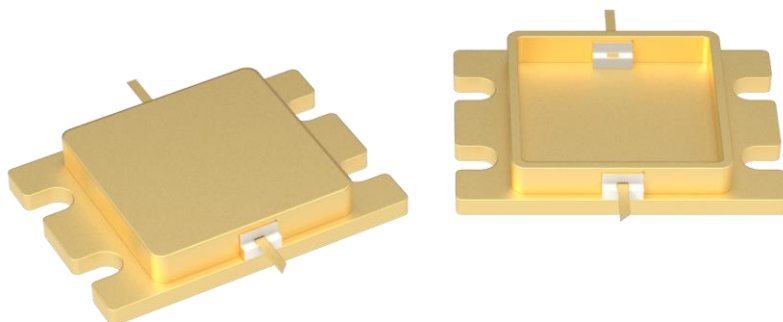
Габаритный чертеж



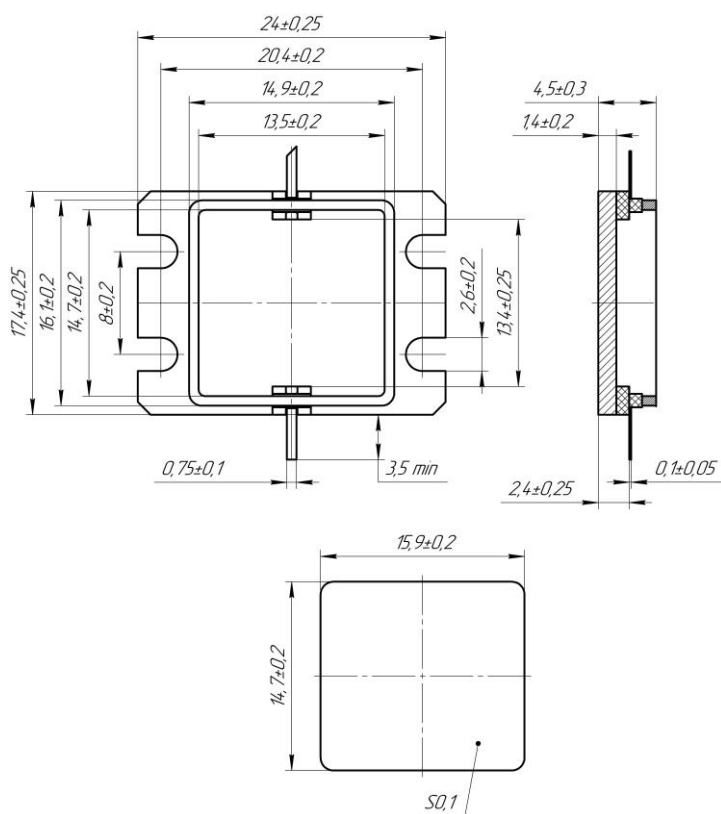
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	26,4×17,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	16,2×14,4
Покрытие	НЗ.ЗлЗ
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..12,0

Корпус МК2-240-01 (ТЛВШ.432269.007) с діапазоном частот до 18 ГГц



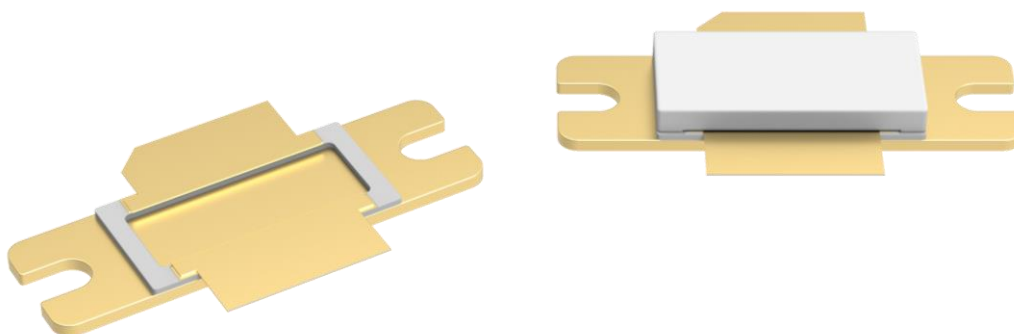
Габаритный чертеж



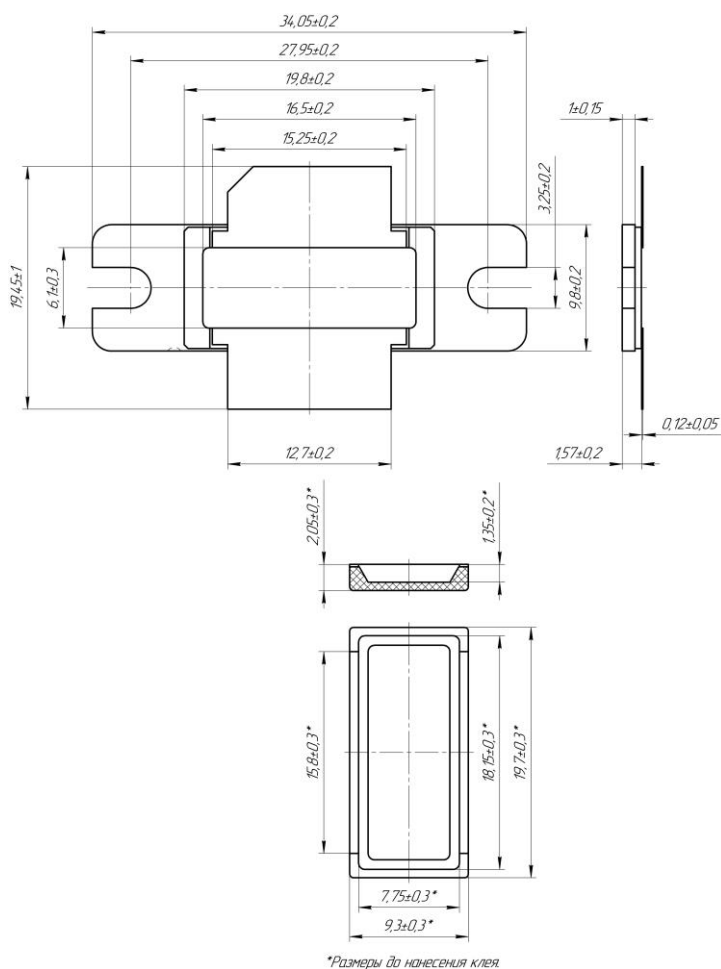
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	24,0×17,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	13,5×14,7
Покрытие	H2,5.3л1,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	шовно- роликовая сварка
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус МК2-340-01 (ТЛВШ.432269.008) с диапазоном частот до 4 ГГц



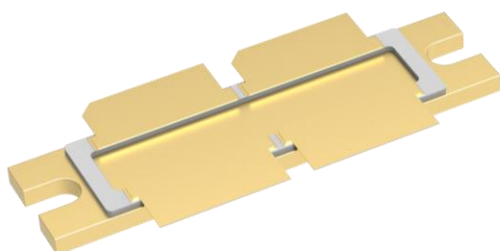
Габаритный чертеж



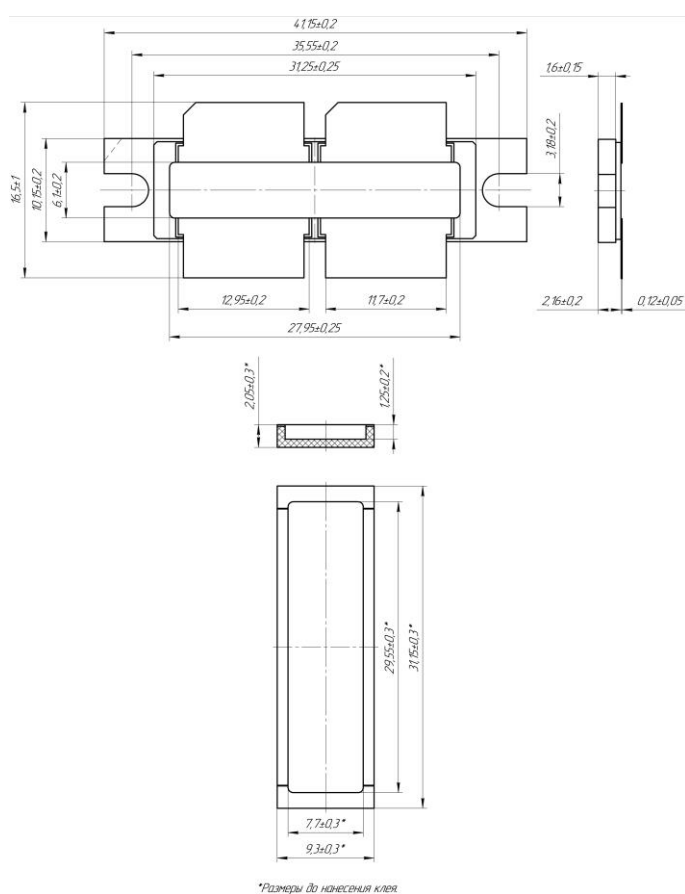
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	34,0×9,8
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	16,5×6,1
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК4-411-01 (ТЛВШ.432269.009) с диапазоном частот до 4 ГГц



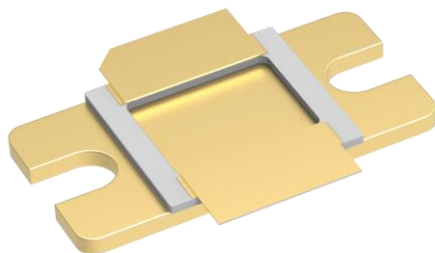
Габаритный чертеж



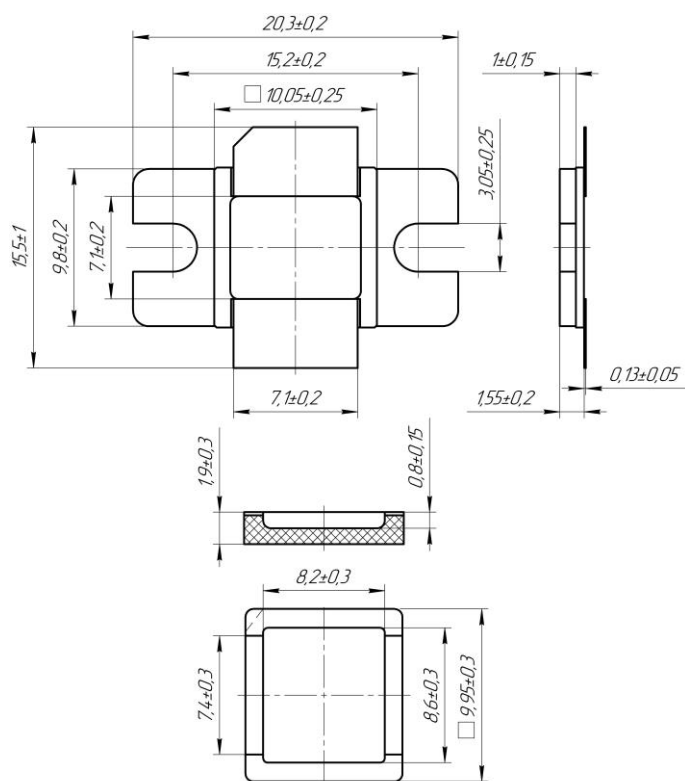
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	41,1×10,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,8
Размер монтажной площадки, мм	27,9×6,1
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК2-203-01 (ТЛВШ.432269.010) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

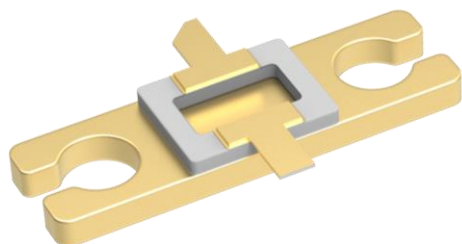


*Размеры до нанесения клея.

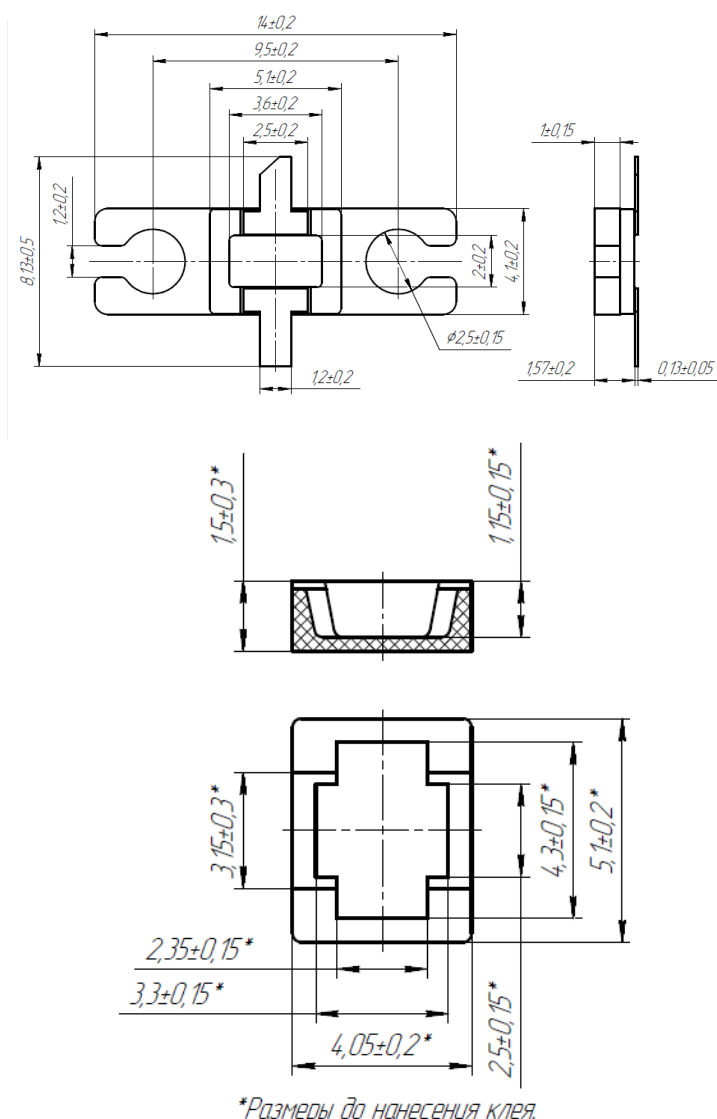
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×9,9
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,2
Размер монтажной площадки, мм	16,5×6,1
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..4,0

Корпус МК2-140-01 (ТЛВШ.432269.012) с диапазоном частот до 6 ГГц



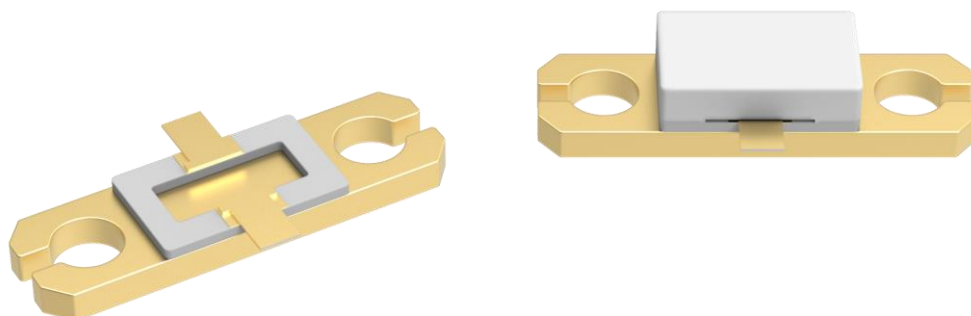
Габаритный чертеж



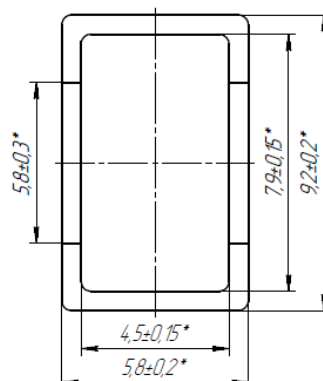
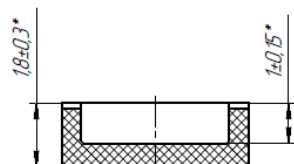
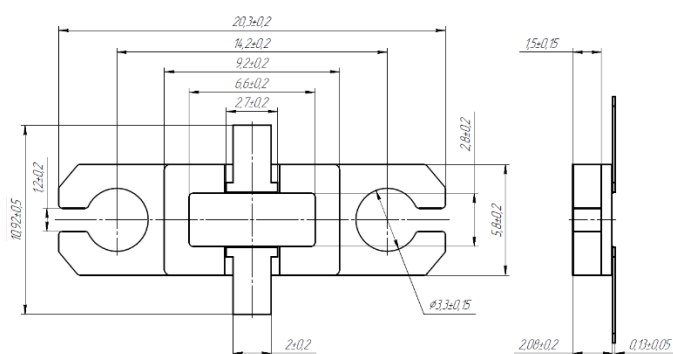
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	14,0×4,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Размер монтажной площадки, мм	3,6×2,0
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..6,0

Корпус МК2-203-02 (ТЛВШ.432269.013) с диапазоном частот до 6 ГГц



Габаритный чертеж

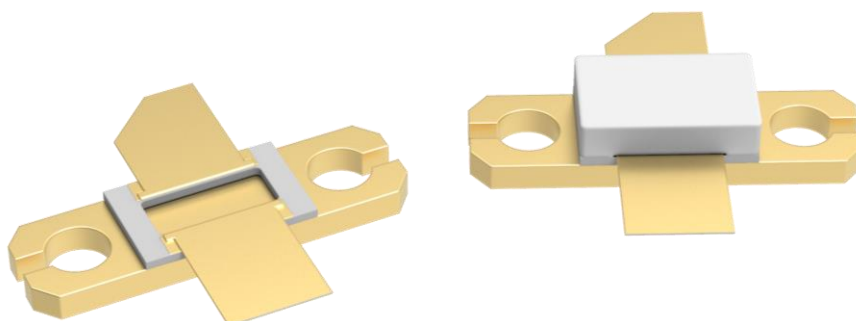


*Размеры до нанесения клея

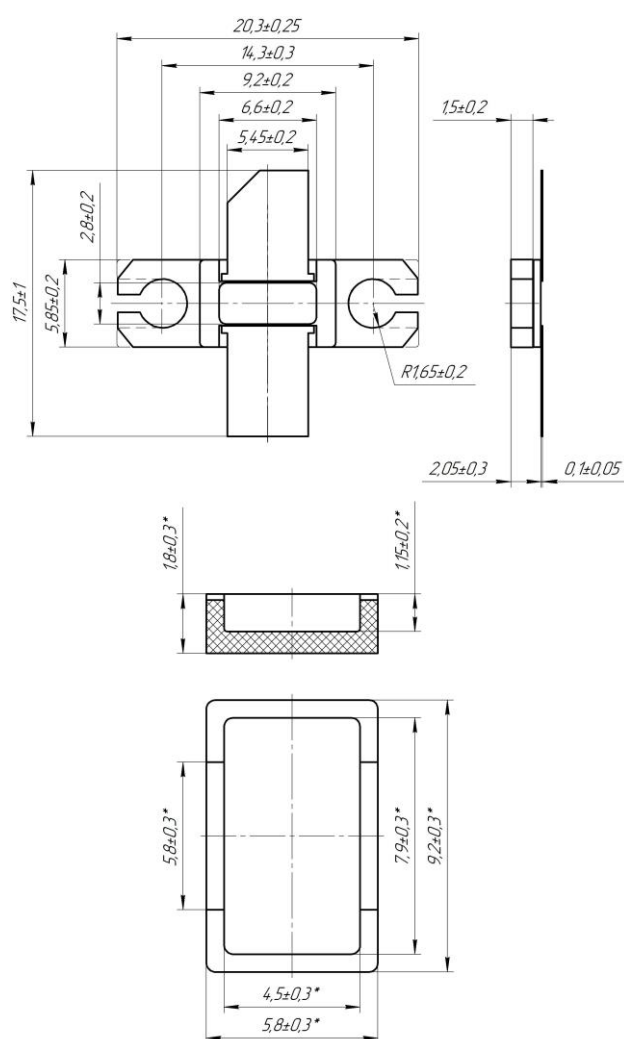
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×5,8
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,6×2,8
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..6,0

Корпус МК2-203-03 (ТЛВШ.432269.014) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

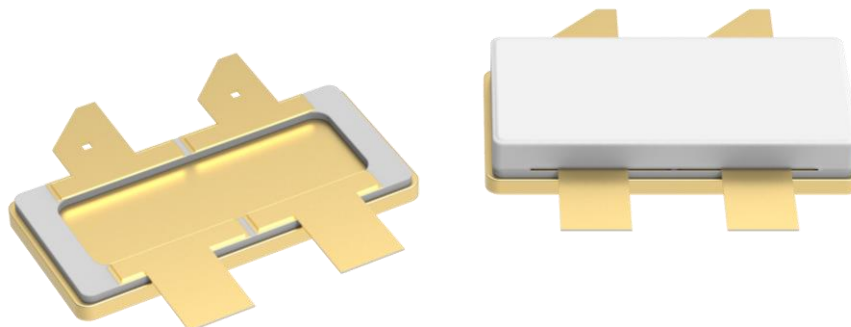


*Размеры до нанесения клея.

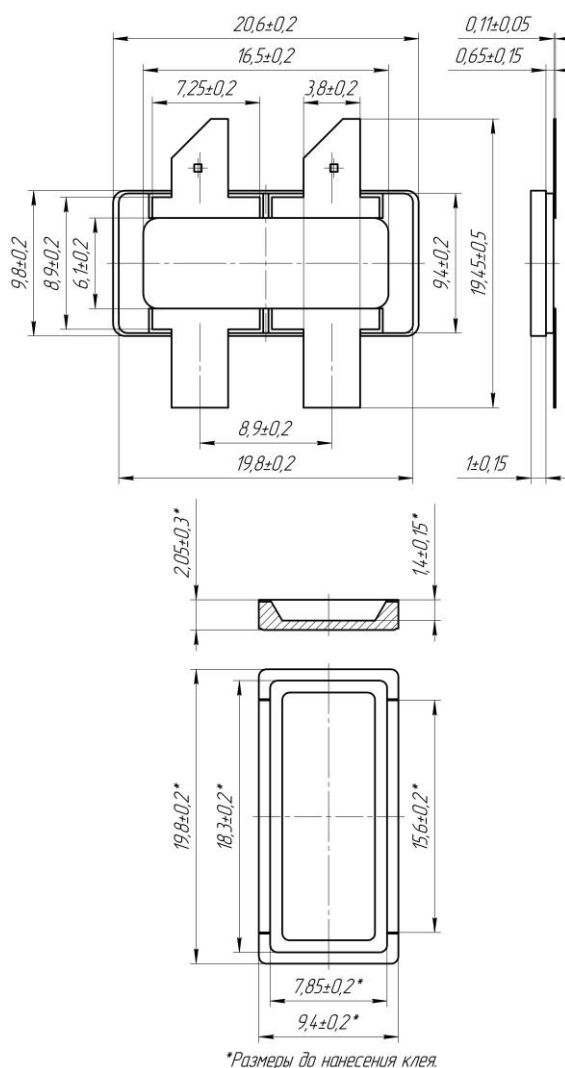
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×5,85
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,6×2,8
Покрытие	Н1,3.3л1,3
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК4-206-01 (ТЛВШ.432269.015) с диапазоном частот до 4 ГГц



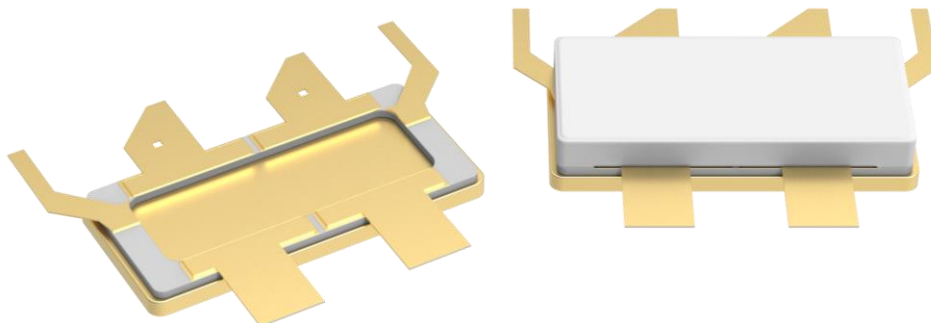
Габаритный чертеж



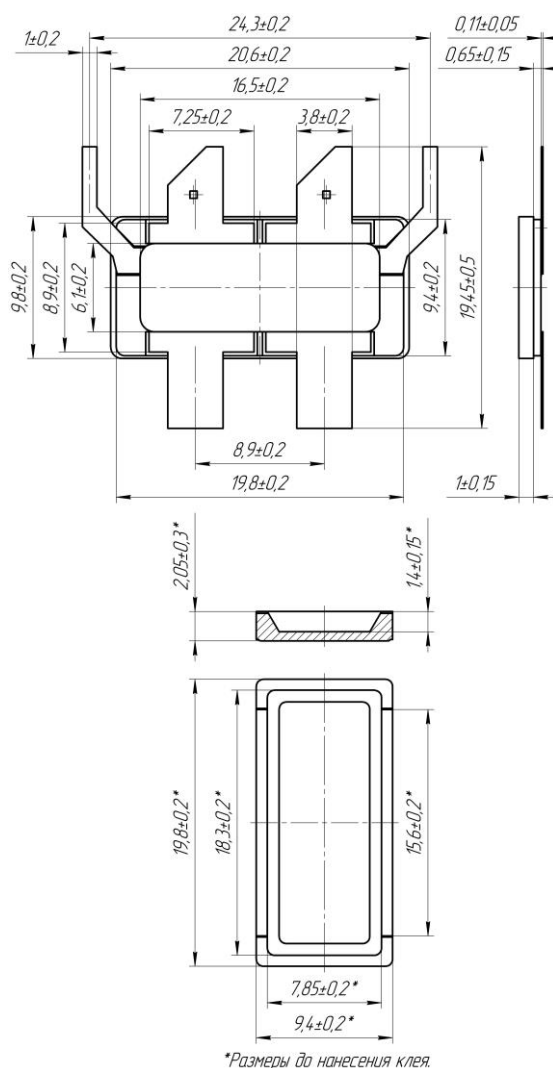
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	4
Шаг выводов, мм	8,9
Размеры основания, мм	9,8×20,6
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,1×16,5
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК4-206-02 (ТЛВШ.432269.016) с диапазоном частот до 4 ГГц



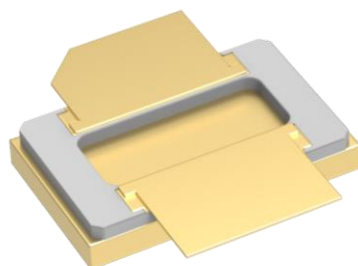
Габаритный чертеж



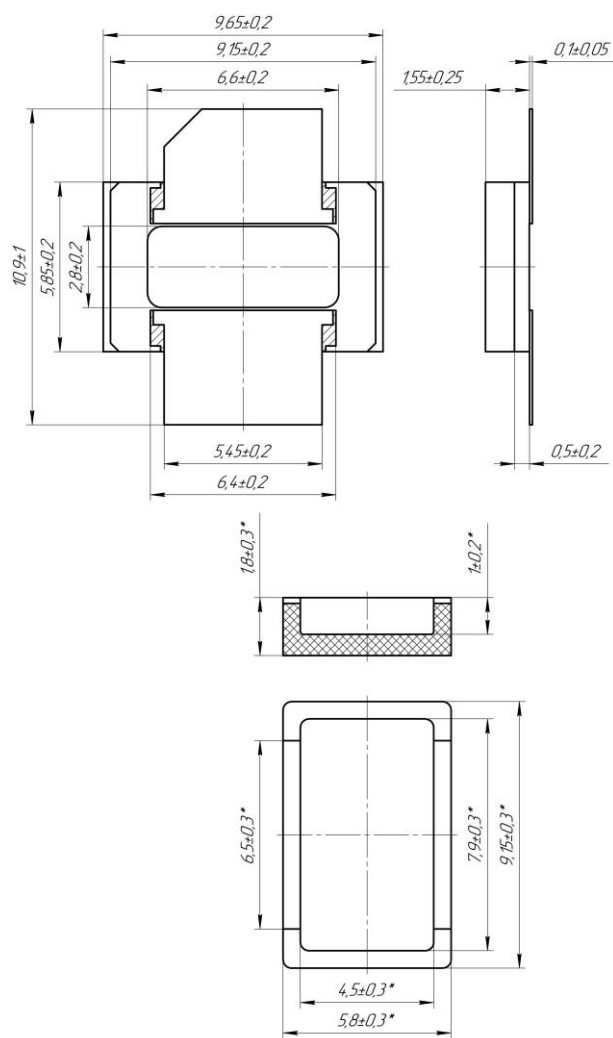
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	4
Шаг выводов, мм	8,9
Размеры основания, мм	9,8×20,6
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,1×16,5
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК2-5896-01 (ТЛВШ.432269.017) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

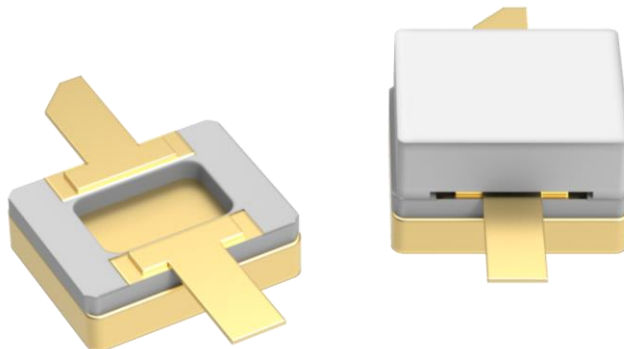


*Размеры до нанесения клея.

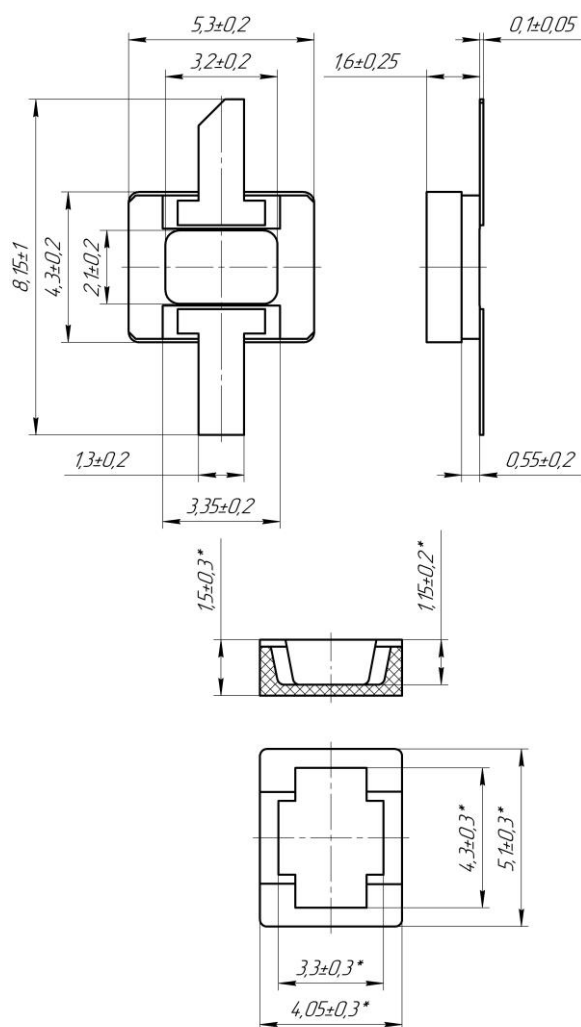
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	5,85×9,65
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	2,8×6,6
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК2-4353-01 (ТЛВШ.432269.018) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

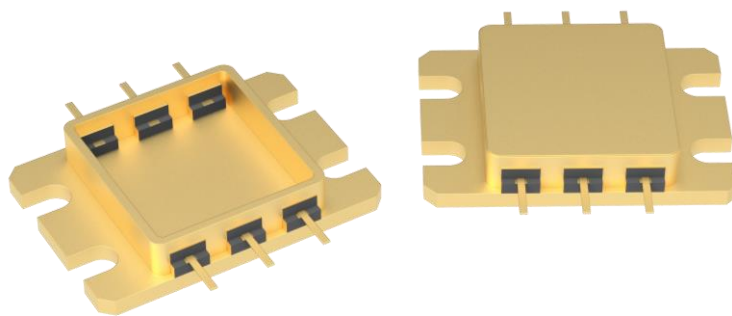


*Размеры до нанесения клея.

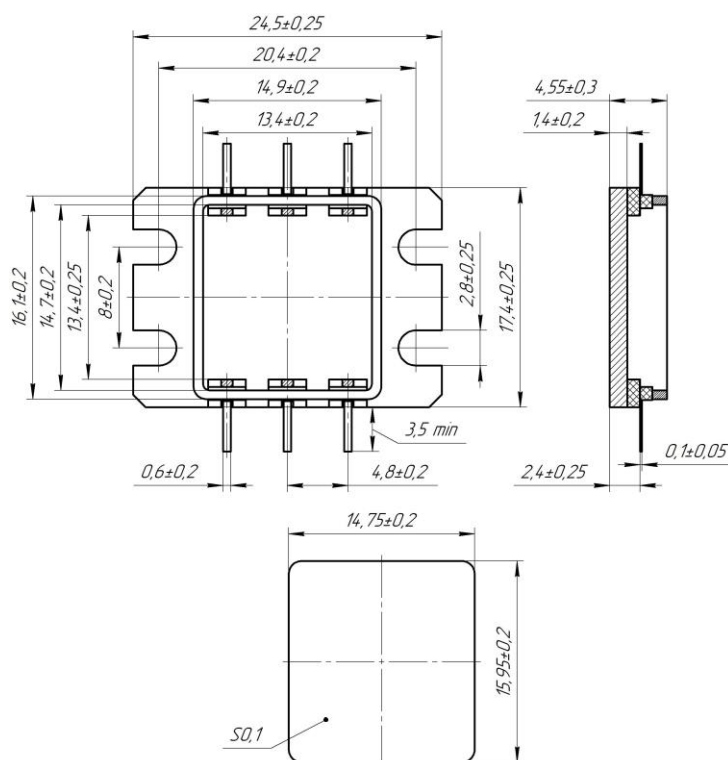
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	4,3×5,3
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	2,1×3,2
Покрытие	H2,5.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус МК6-245-01 (ТЛВШ.432269.019) с диапазоном частот до 18 ГГц



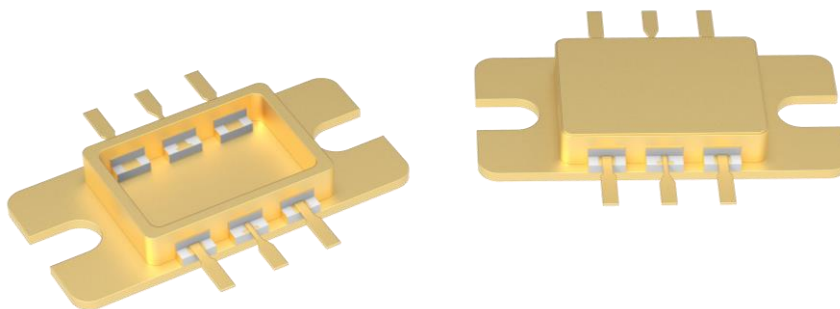
Габаритный чертеж



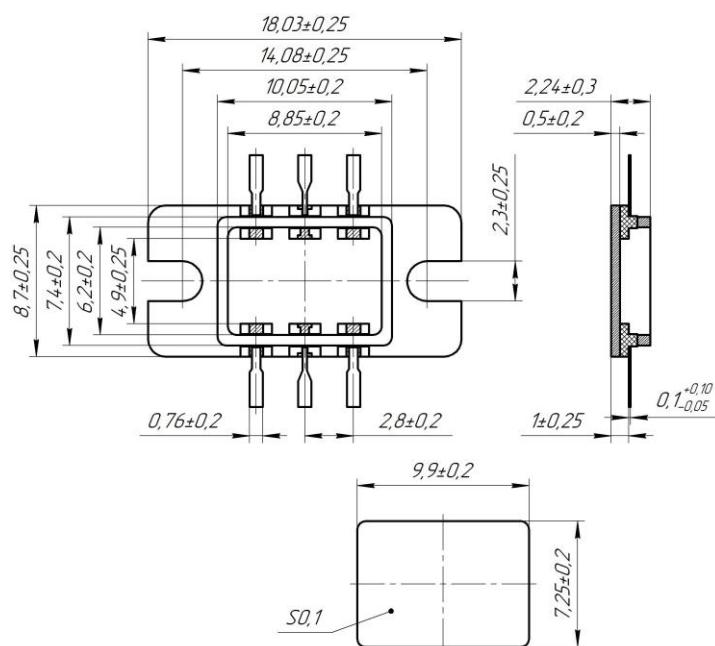
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	6
Шаг выводов, мм	4,8
Размеры основания, мм	17,4×24,5
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,1
Размер монтажной площадки, мм	13,4×13,4
Покрытие	Н1,3.3л1,3
Метод крепления кристалла в корпусе	Клей, пайка
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..18,0

Корпус МК6-180-01 (ТЛВШ.432269.020) с диапазоном частот до 18 ГГц



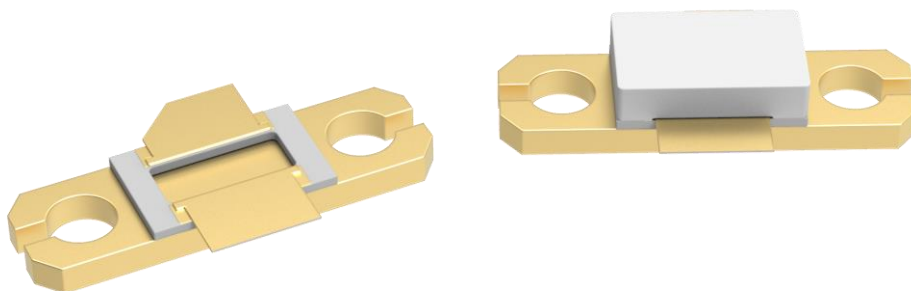
Габаритный чертеж



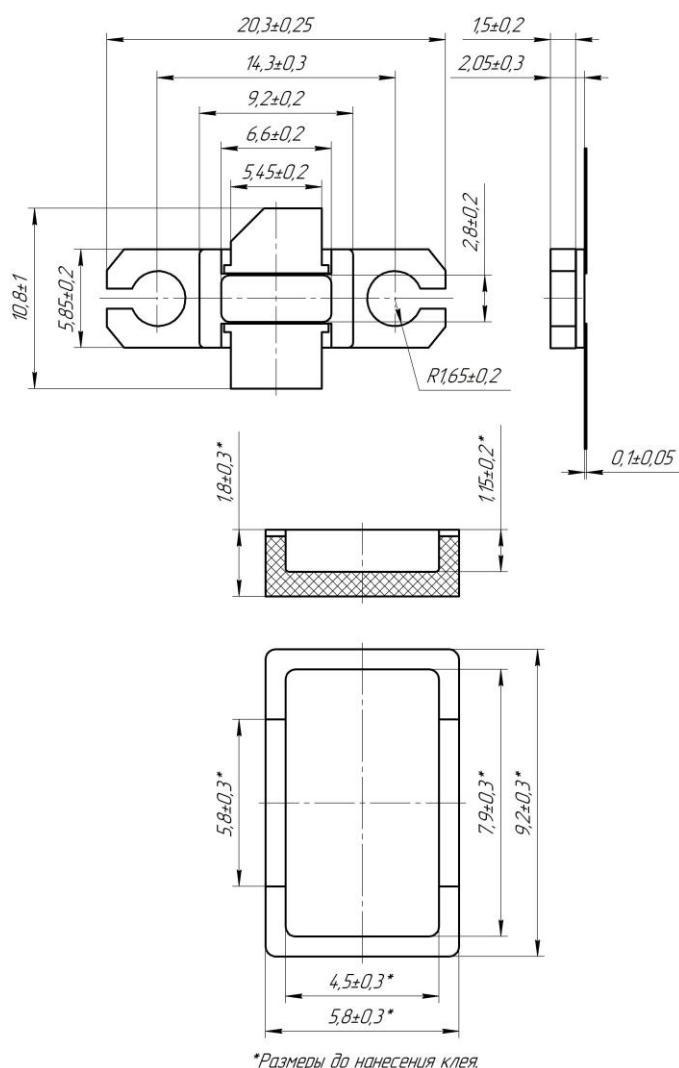
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	6
Шаг выводов, мм	2,8
Размеры основания, мм	8,7×18,03
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,8
Размер монтажной площадки, мм	4,90×8,85
Покрытие	Н1,3.3л1,3
Метод крепления кристалла в корпусе	Клей, пайка
Метод герметизации	шовно-роликовая сварка
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, Гц, S11 ≤ -10 дБ	0,01..18,0

Корпус МК2-203-04 (ТЛВШ.432269.021) с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

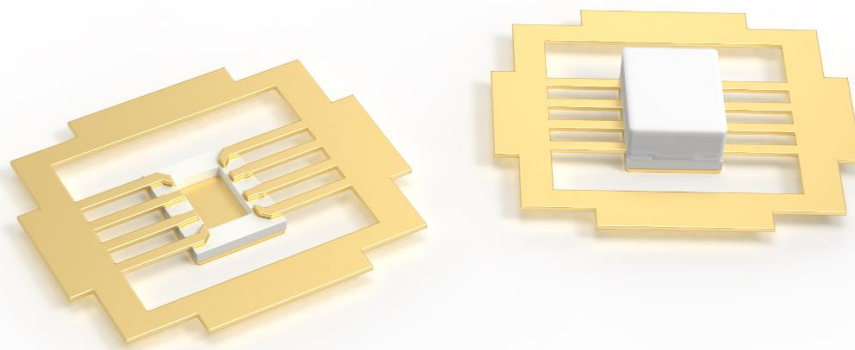


Технические характеристики

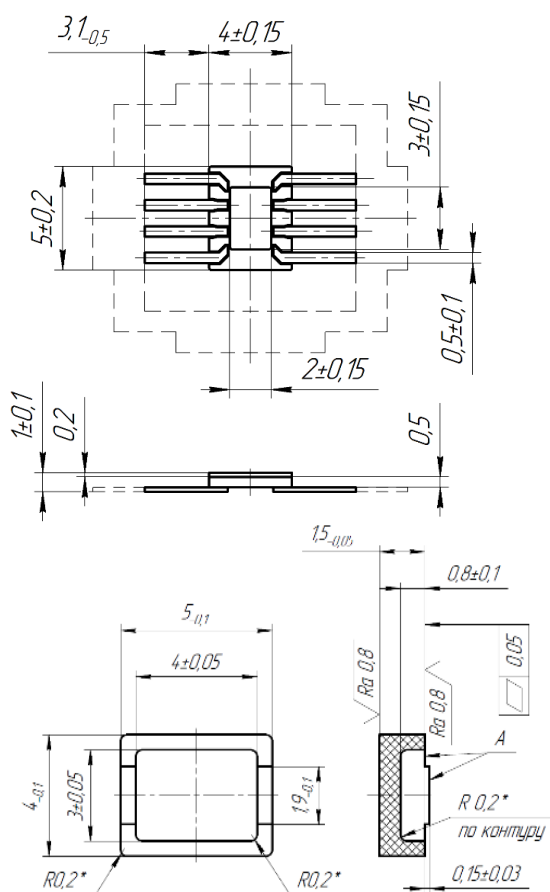
Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×5,85
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,6×2,8
Покрытие	H1,3.3л1,3
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС

Корпус МК8-4050-01 (ТЛВШ.301175.004) с діапазоном частот до 7 ГГц



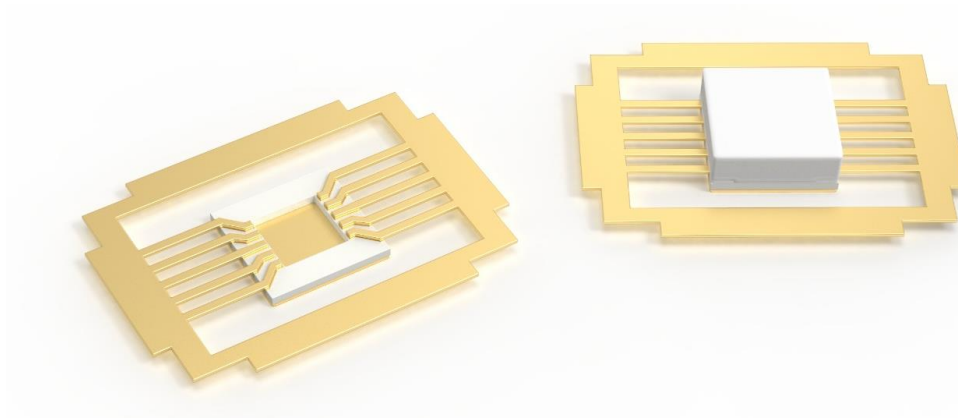
Габаритный чертеж



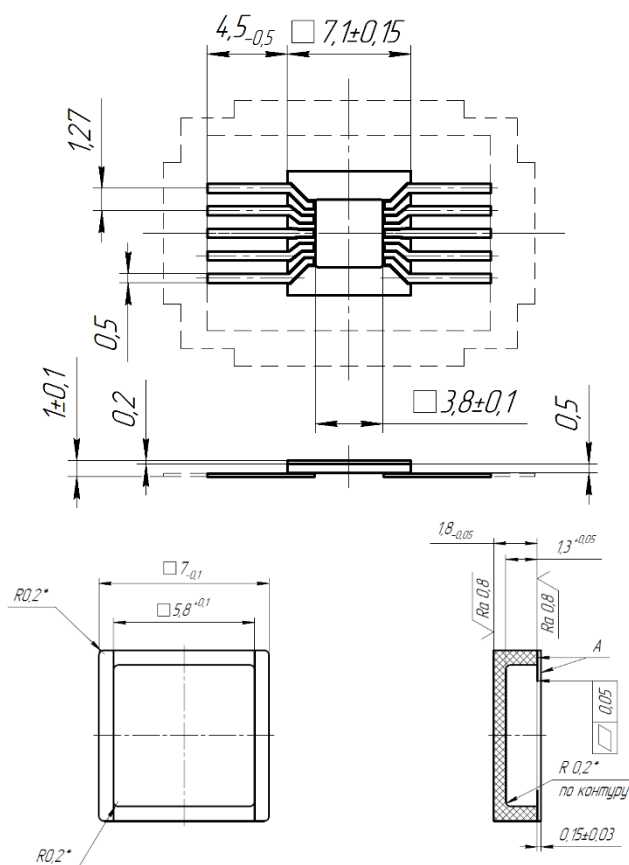
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	4,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,0
Длина выводов, мм, не менее	3,0
Размер монтажной площадки, мм	2,0×3,0
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..7,0

Корпус МК10-7171-01 (ТЛВШ.301175.005) с діапазоном частот до 17 ГГц



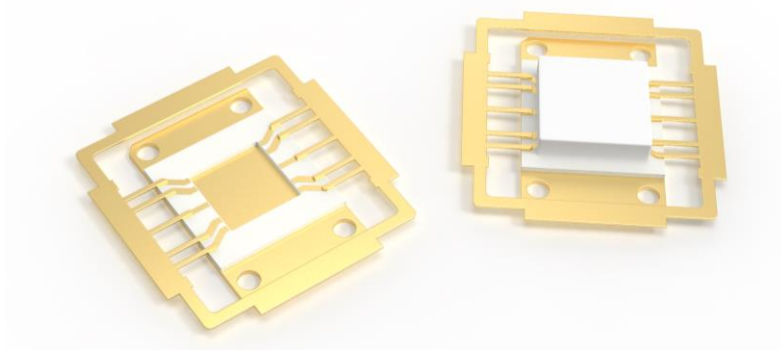
Габаритный чертеж



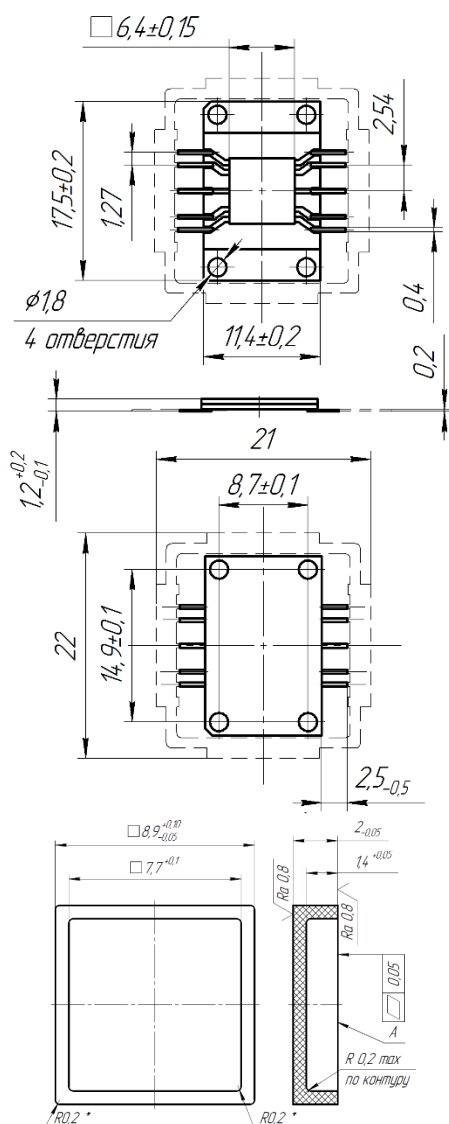
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	7,1×7,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,2
Длина выводов, мм, не менее	4,0
Размер монтажной площадки, мм	3,8х3,8
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..17,0

Корпус МК10-175-01 (ТЛВШ.301175.006) с диапазоном частот до 18 ГГц



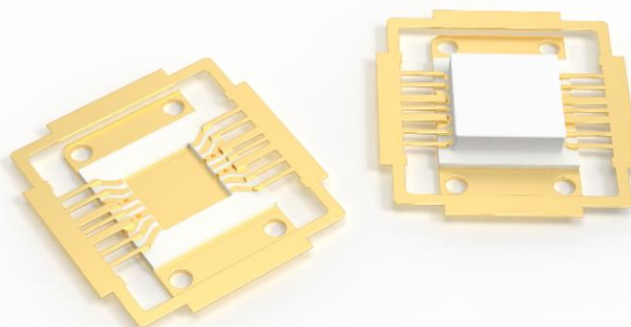
Габаритный чертеж



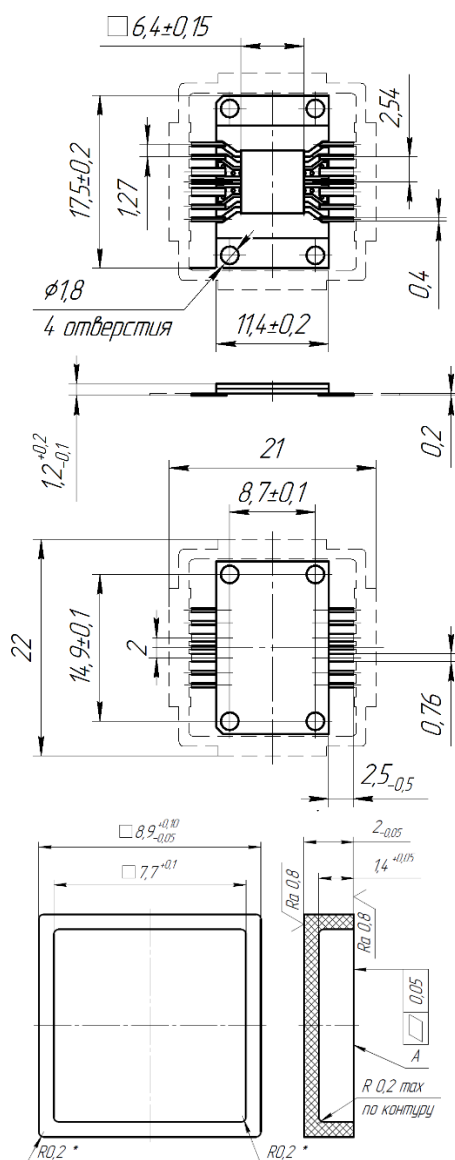
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Длина выводов, мм, не менее	2
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус МК14-175-01 (ТЛВШ.301175.007) с диапазоном частот до 18 ГГц



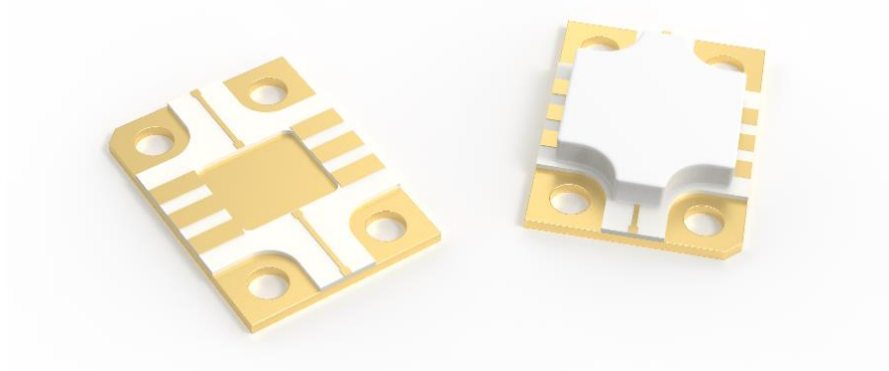
Габаритный чертеж



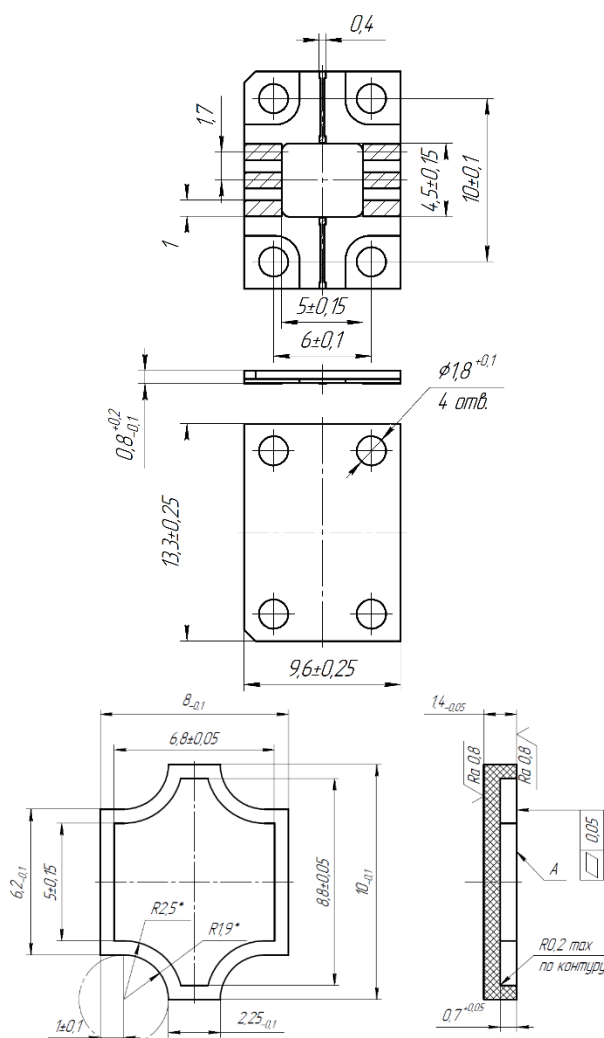
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	14
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Длина выводов, мм, не менее	2,0
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус МК8-133-01 (ТЛВШ.301175.009) с диапазоном частот до 22 ГГц



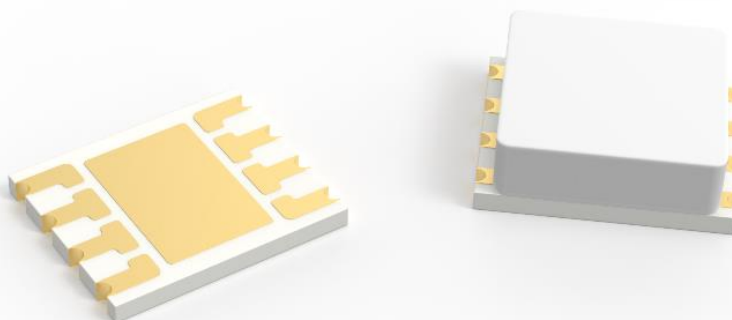
Габаритный чертеж



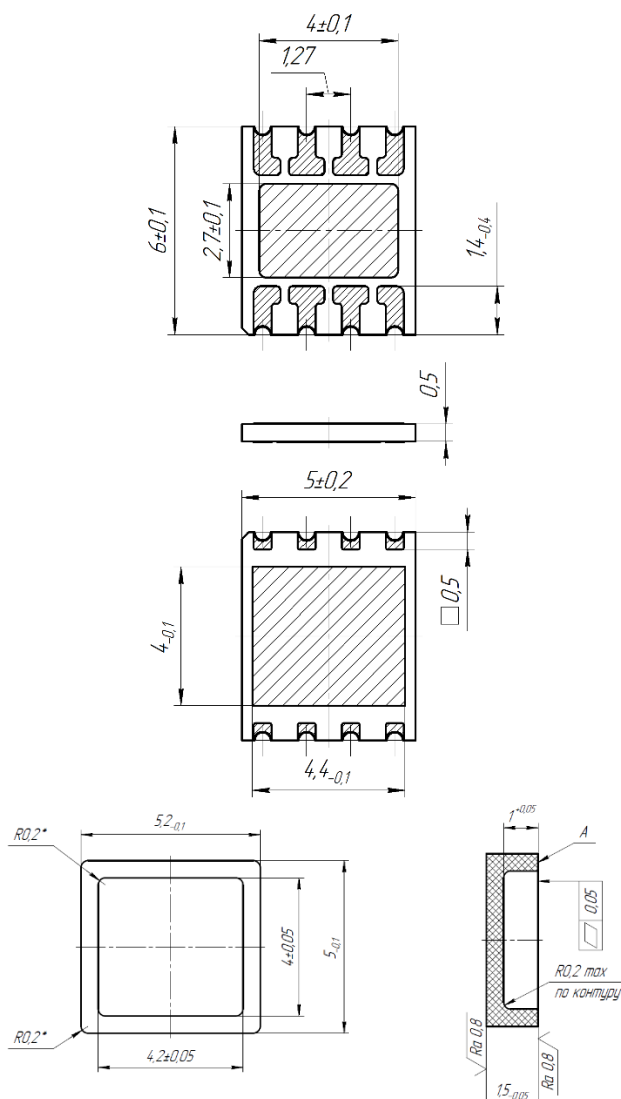
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,7
Размеры основания, мм	13,3×9,6
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	5×4,5
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ ≤ 1,75	0,01..22,0

Корпус КП8-5060-01 (ТЛВШ.301175.010) с диапазоном частот до 20 ГГц



Габаритный чертеж



Технические характеристики

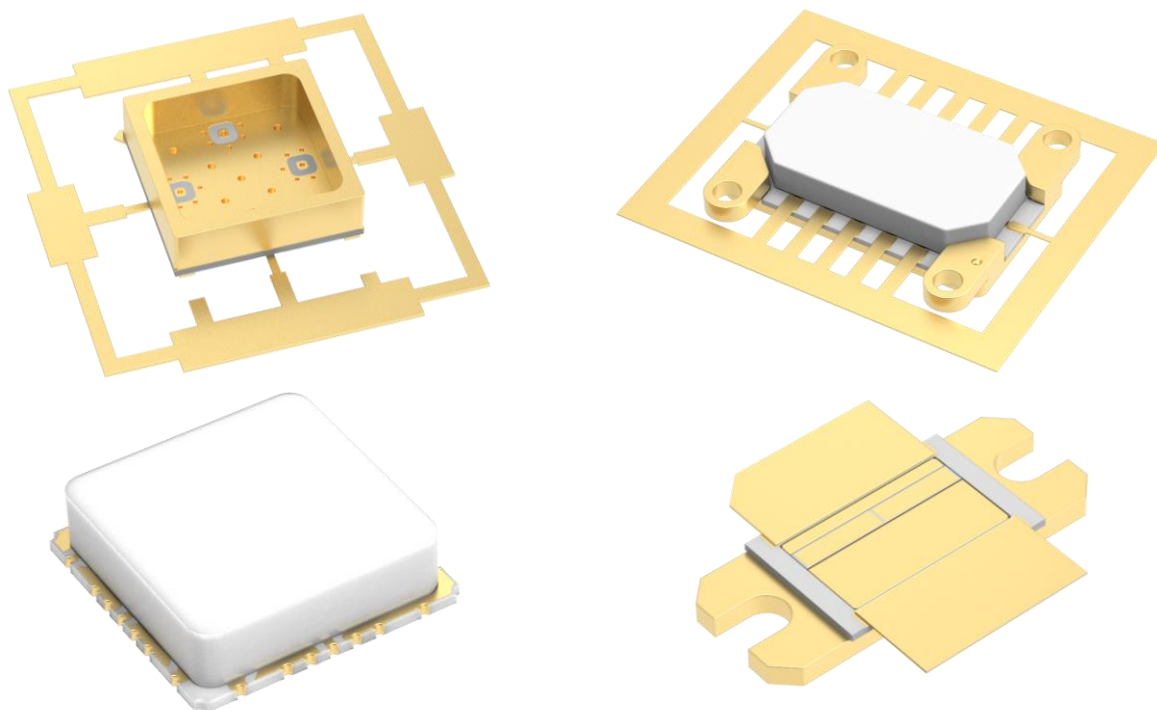
Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	6,0x5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,0
Размер монтажной площадки, мм	4,0x2,7
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..20,0

Варианты исполнения:

**Корпус ТЛВШ.301175.010–
материал основания ALN-
170**

**Корпус ТЛВШ.301175.010-
01– материал основания
Al₂O₃ 99,6%**

Разработка и изготовление корпусов под требования Заказчика



Металлокерамические корпуса для изделий СВЧ-электроники

Параметры

Диапазон рабочих частот

до 40 ГГц

Габаритные размеры, количество выводов, размер посадочного места

по ТЗ Заказчика

Метод герметизации

клей, шовно-роликовая сварка

Типовые материалы основания

Al₂O₃, Cu, WCu, MoCu, CPC

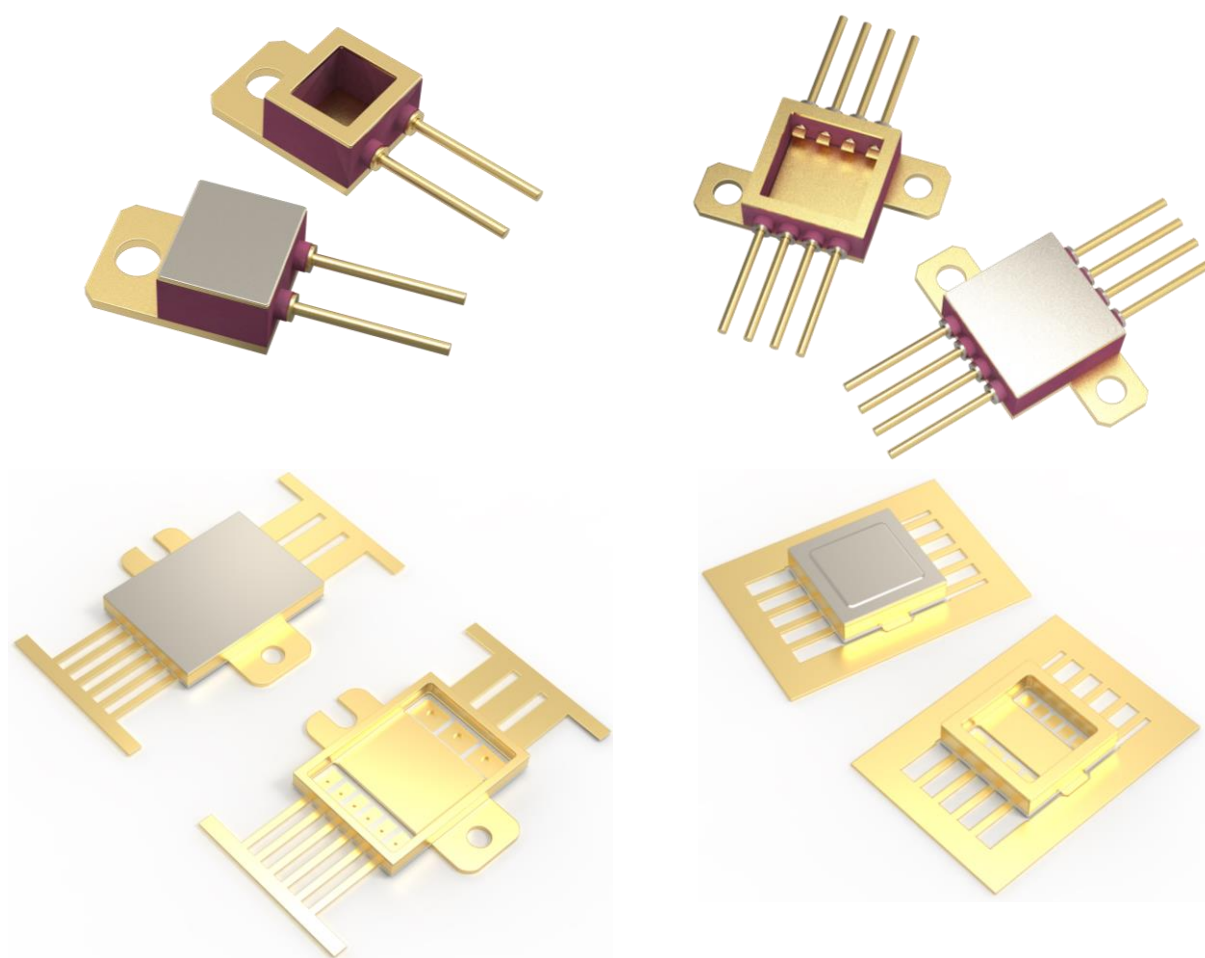
Типовое покрытие

никель-золото

Показатель герметичности

$\leq 1 \cdot 10^{-3} \text{Па} \cdot \text{см}^3/\text{с}$

Разработка и изготовление корпусов под требования Заказчика



Металлокерамические корпуса для изделий силовой электроники

Параметры

Габаритные размеры, количество выводов, размер посадочного места

по ТЗ Заказчика

Метод герметизации

клей, шовно-роликовая сварка

Типовые материалы основания

Al₂O₃, Cu, WCu, MoCu, CPC

Типовое покрытие

никель-золото

Показатель герметичности

$\leq 1 \cdot 10^{-3} \text{Па} \cdot \text{см}^3/\text{с}$



ООО «ИПК «Электрон-Маш»



+7 (495) 761-75-23



electron-engine.ru



info@electron-engine.ru



124482, г. Москва, г. Зеленоград,
к. 313А